

AMDプロセッサ インストール手順

HP ProLiant DL145
Generation 2サーバ用



取り付けを開始する前に、
必ずこのカードをお読みください。

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品の保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

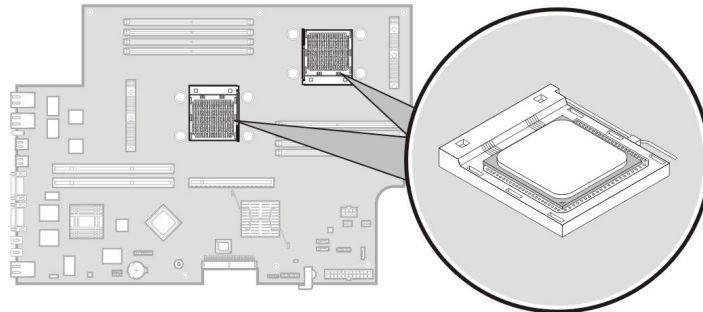
本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で 사용되는場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

AMDプロセッサ インストール手順

初版（2005年3月）
製品番号 381740-191

プロセッサ ソケットの位置確認

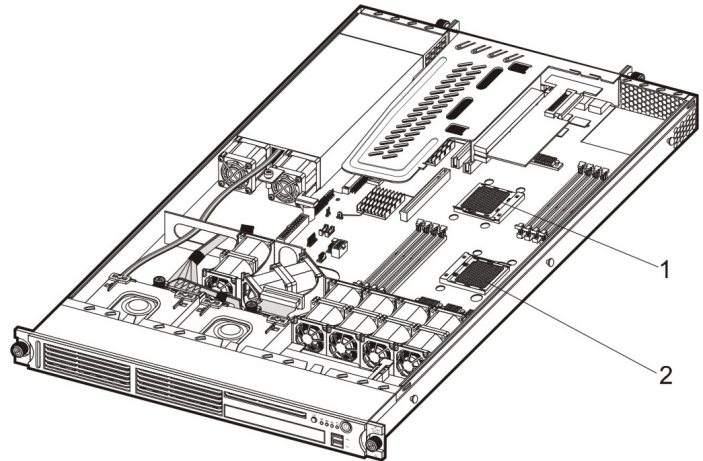
次の図に、サーバに2個あるAMD Opteronプロセッサ ソケット（U11およびU22）の位置を示します。



取り付けのガイドライン

プロセッサを取り付ける際は、次の重要なガイドラインに従ってください。

- プロセッサ ソケット1（U22）には、常にプロセッサを取り付けてください。このソケットにプロセッサが取り付けられていない場合、システムは起動に失敗し、POST実行中に停止します。このエラーにより、システムは正常に機能しなくなります。



- プロセッサおよびヒートシンクは、注意して取り扱ってください。いずれかの部品が損傷すると、プロセッサの性能に影響する場合があります。
- プロセッサの下にあるピンは非常に壊れやすくなっています。ピンを曲げたり傷つけたりしないようにしてください。
- プロセッサを交換する場合は、必ず、新しいヒートシンクを使用してください。新しいヒートシンクを使用しない場合、プロセッサが損傷することがあります。
- サーバのROMが最新バージョンであることを確認してください。プロセッサを取り付ける前にROMをフラッシュしておかないと、システムに障害が発生する場合があります。

プロセッサの構成

注：このカードで説明する手順は、サーバがラック外の水平で安定した場所に置かれていることを前提としています。

重要：プロセッサを構成する際は、以降の各項で説明する取り付け前と取り付け後の手順に従ってください。

注意：プロセッサおよびヒートシンクを扱う際は、『HP ProLiant DL145 Generation 2 Server Maintenance and Service Guide』の第2章のESDに関する注意事項をよく読んでください。このガイドは、HPのWebサイト<http://www.hp.com/>（英語）からダウンロードできます。

警告：サーバのカバーを開く前にサーバの電源を正しく切っておかないと、装置が損傷したり、けがしたりすることがあります。

警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ヒートシンクおよびプロセッサが十分に冷めてから手を触れてください。

注意：取り付け時や取り外し時にヒートシンクが傾かないように、4本のスプリング式ネジは、対角線の順序で（Xの字を描くように）、緩めたり締めたりしてください。

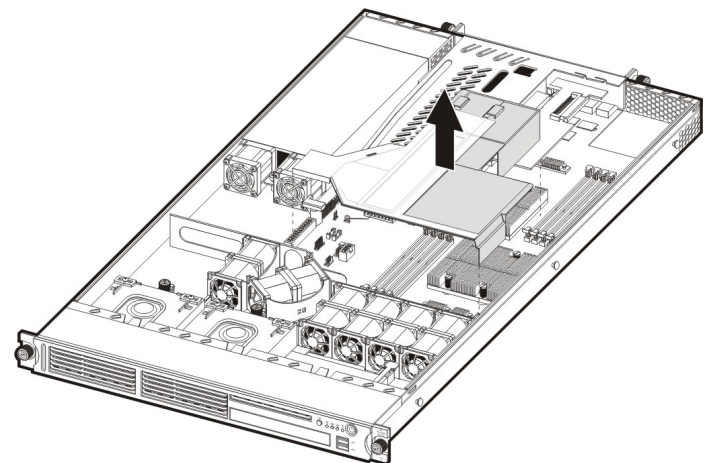
取り付け前の手順

プロセッサの取り外しまたは取り付けの前に、以下の手順を実行してください。

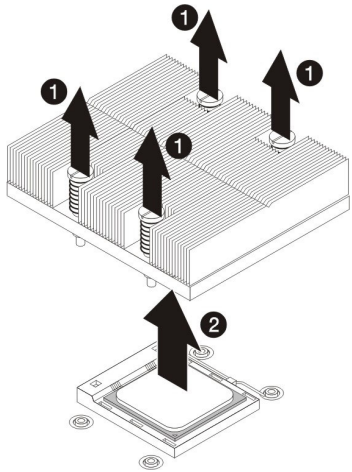
- サーバおよびサーバに接続されているすべての周辺装置の電源を切ります。
- 感電の危険を防止するために、サーバのリア パネルのパワー サプライ ケーブル ソケットからAC電源コードを抜き取ります。
- トップカバーを取り外します。
- 必要に応じて、エア ダクトへのアクセスの障害となるアクセサリ ボードやケーブルを取り外します。

プロセッサの取り外し

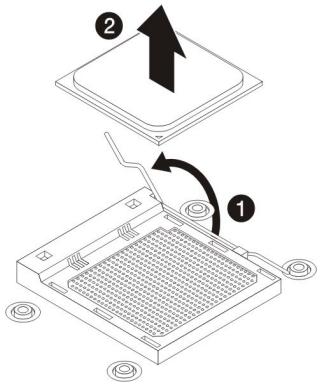
- 前の項で説明した取り付け前の手順を実行します。
- エア ダクトを持ち上げて、プロセッサ ソケットから外します。エア ダクトは、後で取り付けることができるように保管しておきます。



- 3. 取り外すプロセッサの位置を確認します。
- 4. 次の手順を実行して、ヒートシンクを取り外します。
 - a. 4本のスプリング式ネジを、対角線の順序で少しだけ回して緩めた後、完全に緩めて、ヒートシンクをプロセッサの基盤から外します。
 - b. ヒートシンクを持ち上げて、システム ボードから外します。



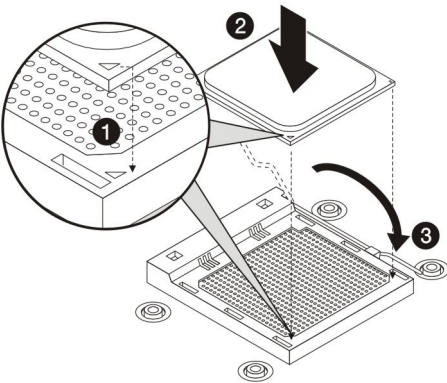
- 5. 次の手順を実行して、プロセッサを取り外します。
 - a. プロセッサの基盤からソケット固定用レバーを外します。
 - b. プロセッサの端を持ってプロセッサを持ち上げて、ソケットから取り出します。



- 6. プロセッサを静電気防止処理のされた作業台の上に置くか、静電気防止バッグの中に入れます。

プロセッサの取り付け

- 1. 「プロセッサの取り外し」の項の手順1および2を実行します。
- 2. 空いているプロセッサ ソケットの位置を確認します。
- 3. プロセッサの基盤からソケット固定用レバーを外します。
- 4. 次の手順を実行して、プロセッサを取り付けます。
 - a. プロセッサを空きプロセッサ ソケットの上に持っていきます。プロセッサの端以外は持たないでください。プロセッサのピン1（隅にある金色の三角形で識別できます）の位置と、ソケットのホール1（ノッチで識別できます）の位置が一致していることを確認します。ピンにはキーが付けられており、プロセッサの挿入方向を誤るとピンが折れ曲がります。
 - b. プロセッサをソケットに挿入します。
 - c. ソケット固定用レバーを元に戻します。



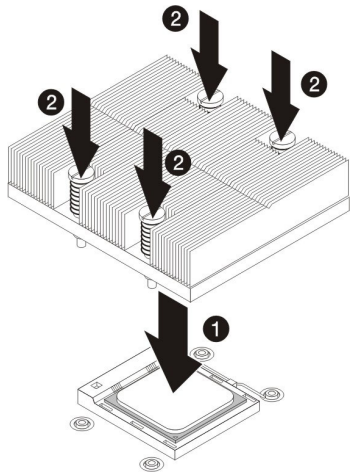
プロセッサが正常に機能するには、ヒートシンクを取り付ける必要があります。ProLiantサーバ用のヒートシンク モデルの下部には、接触面用の熱伝導材が貼られており、プラスチック製のカバーで保護されています。この熱伝導材に、引っかき傷や隙間がないことを確認します。引っかき傷や隙間がある場合は、HPのサービス窓口に連絡して交換を依頼してください。

注意： 過熱、または過熱によるシステム クラッシュを防止するために、ProLiantモデル用に指定されたヒートシンク モデル以外は使用しないでください。

- 5. 接触面用の熱伝導材を保護しているプラスチック製のカバーを外して廃棄します。接触面用の熱伝導材に触れたり、傷を付けたりしないようにしてください。
- 6. 次の手順を実行して、ヒートシンクを取り付けます。
 - a. ヒートシンクの位置をプロセッサに合わせ、プロセッサの上に置きます。

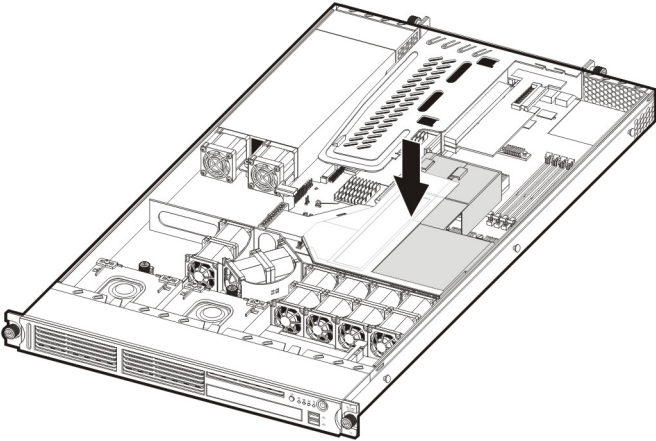
注意： ヒートシンクのスプリング式ネジを締めすぎないようにしてください。締めすぎると、ネジが壊れます。このシステムでは、最大トルクを6インチ/ポンドに設定してください。

- b. 4本のスプリング式ネジを、対角線の順序で少しだけ回して締めた後、完全に締めて、ヒートシンクをプロセッサの基盤に固定します。



重要： ヒートシンクを何らかの理由で取り外した場合は、プロセッサの内蔵ヒート スプレッダに接触面用の熱伝導材を塗布しなおして、プロセッサとヒートシンク間が正しく熱結合するようにしなければなりません。プロセッサとヒートシンクの接触部分をアルコール パッドできれいに拭き、HP認定の接触面用の熱伝導材を薄く塗布してからプロセッサを取り付けてください。ProLiantサーバには、ShinEtsu G751サーマル グリース コンパウンドの使用をおすすめします。

- 7. エア ダクトを元の場所に戻します。



- 8. 次の項で説明する取り付け後の手順を実行します。

取り付け後の手順

プロセッサの取り外しまたは取り付け後は、以下の手順に従ってください。

- 1. すべてのコンポーネントが、説明されている手順に従って取り付けられていることを確認します。
- 2. サーバ内に残っている工具や固定されないまま残っている部品がないかどうかを調べます。
- 3. 取り外した拡張ボード、周辺装置、ボード カバー、およびシステム ケーブルを取り付けなおします。
- 4. トップ カバーを元に戻します。
- 5. すべての外部ケーブルとAC電源コードをシステムに接続します。
- 6. フロント パネルの電源ボタン (⏻) を押して、サーバの電源を入れます。